

【名稱】：DFN16 & SSOP/MSSOP/TSSOP16 & SO/SOIC/SOP16 轉 DIP16 轉

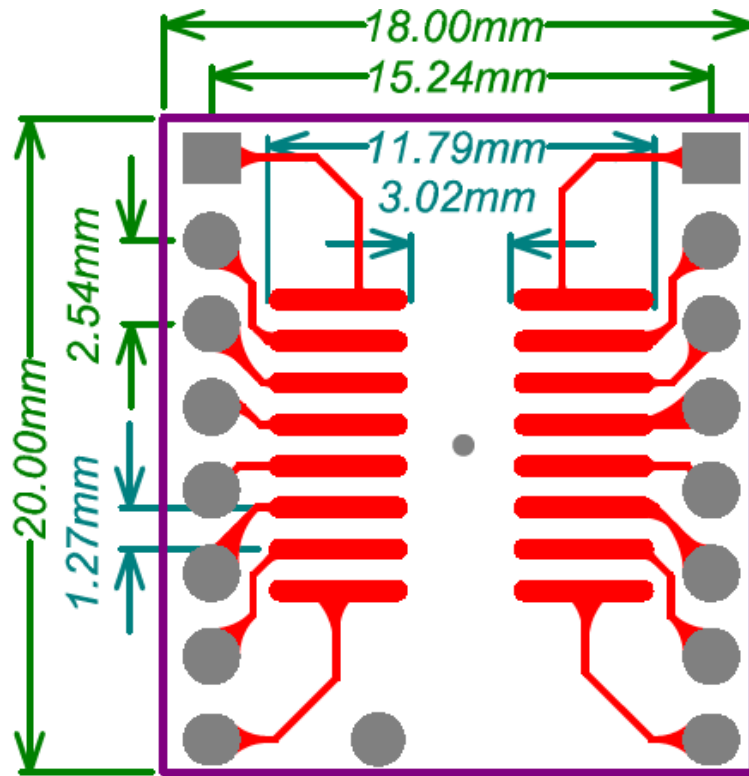
接板支持寬窄體 IC (貼片轉外掛程式)

【描述】：板層：2 層板 (又稱雙面板或雙層板) 正面：SO/SOIC/SOP16 轉 D
IP16 Pitch:1.27mm (引腳間距：SOP 為：1.27mm) 相容寬體與窄體晶片，
背面：MSOP10 & SSOP/MSOP16/TSSOP16 轉 DIP16 Pitch:0.5mm&0.65mm
(引腳間距：TSSOP 為：0.65mm、MSOP10 為：0.5mm) ；

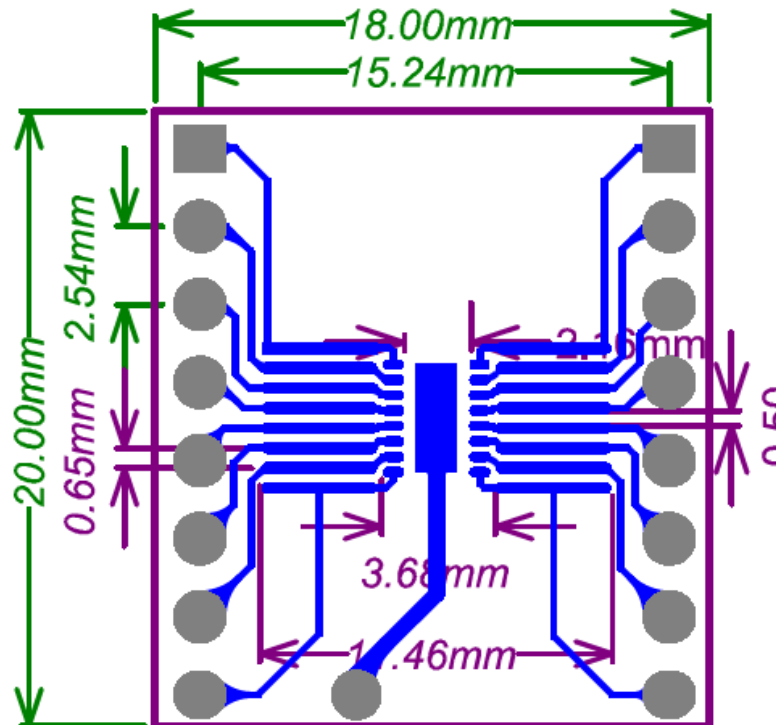
- 板材：FR4 板材 (採用 KB 公司軍工級 A 級環保板材，軍工品質) 該
板材的絕緣性，板材的均勻性，銅皮跟板材基材的可靠性並且銅皮不易縮水，
板材的阻抗穩定性；板厚：1.6mm 超厚不易變形；
- 焊盤：採用化學沉金工藝 (即焊盤表面鍍金)。焊點更牢靠、美觀、防
腐蝕、抗氧化、無鉛更環保。

【用途】：本轉接板適用於以下“貼片晶片封裝”轉成外掛程式，親，購買時務必
請仔細核對。

- SO/SOIC/SOP16 轉 DIP16 Pitch：1.27mm 即：焊盤
間距離 (引腳間距) <焊接位置：轉接板正面>
- SSOP/MSOP16/TSSOP16 轉 DIP16 Pitch：0.65mm 即：焊盤間距
離 (引腳間距) <焊接位置：轉接板反面>
- DFN16 轉 DIP Pitch：0.5mm 即：
焊盤間距離 (引腳間距) <焊接位置：轉接板反面>



- 上圖為<正面>：SO16 SOIC16 SOP16（支援寬窄體晶片）焊盤間距 Pitch：1.27 mm DIP：2.54mm



- 上圖為<背面>：DFN16 & SSOP/MSOP16/TSSOP16 焊盤間距 Pitch：0.5mm&0.65mm DIP：2.54mm